

**OMNIMATE Data - gniazda RJ45
RJ45C5 R1V 3.2N4N RL****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



Asortyment produktów obejmuje następujące konstrukcje:

- 90°, leżąca (pozioma) oraz 180°, stojąca (pionowa)
- górny zatrzask / dolny zatrzask
- Procesy lutowania THT, THR lub SMD
- Szeroki wybór różnorodnych konstrukcji, także z wbudowanymi kontrolkami LED oraz zaciskami ekranu
- Klasa parametrów Kat. 3 do Kat. 6
- Pakowane albo na tacy (TY) lub na rolce (taśma na szpuli, RL)

Właściwości i zalety:

- Rozszerzony zakres temperatur od -40°C do +85°C umożliwiające użytkowanie w różnorodnych warunkach
- Wzmocniona warstwa złota (30µm) dla lepszego zabezpieczenia przed korozją
- Odstęp minimum 3 mm zapewnia idealne rezultaty lutowania.

Ogólne dane do zamówienia

Typ	RJ45C5 R1V 3.2N4N RL
Nr zam.	2562970000
Wykonanie	Złącze wtykowe do druku, Gniazda RJ45, Cat. 5, Połączenie lutowane THT/THR, 180°, Zaciski ekranu: brak, 30-80 µm Ni / 30- µm Au, LED: Nie, Liczba biegunów: 8, Tape
GTIN (EAN)	4050118571998
J. op.	200 Szt.
opakowanie	Tape

**OMNIMATE Data - gniazda RJ45
RJ45C5 R1V 3.2N4N RL****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmüller.com

Dane techniczne**Wymiary i ciężary**

Szerokość	16 mm	Szerokość (cale)	0,63 inch
Wysokość	20 mm	Wysokość (cale)	0,787 inch
Najmniejsza wysokość montażu	16,5 mm	Głębokość	16,7 mm
Głębokość (cale)	0,657 inch	Masa netto	10 g

Temperatury

Temperatura magazynowania, max.	85 °C	Temperatura magazynowania, min.	-40 °C
Temperatura pracy, max.	85 °C	Temperatura pracy, min.	-40 °C

Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
------------	----------------

Specyfikacje systemu

Średnica otworu montażowego (D)	0,9 mm	Cykle wpinania	750
Długość pinu do lutowania (l)	3,2 mm	Ekranowanie	Tak
Kategoria	Cat. 5	LED	Nie
Liczba biegunów	8	Materiał ekranu	mosiądz
Okablowanie	8-żyłowy	Powierzchnia ekranu	niklowany
Raster w mm (P)	1,27 mm	Raster w calach (P)	0,05 inch
Rodzaj przyłącza	złącze żeńskie	Rodzina produktów	OMNIMATE Data - gniazda RJ45
Stopień ochrony	IP20	Tolerancja średnicy otworu montażowego (D)	± 0,1 mm
Tolerancja długości kołka lutowicznego	+0,5 / -0,5 mm	Zaciski ekranu	brak
kąt odejścia	180°	liczba kołków lutowanych na biegun	1
montaż na płytce drukowanej	Połączenie lutowane THT/THR		

Właściwości elektryczne

Prąd znamionowy	1,5 A	Wytrzymałość izolacji	1000 MΩ at 500 V DC
Wytrzymałość napięciowa styk / styk	1000 V AC	napięcie znamionowe	125 V AC

Dane materiałowe

Materiał izolacyjny	PA 9T	Barwny	czarny
Tabela kolorów (podobny)	RAL 9011	grupa materiałów izolacyjnych	II
CTI	≥ 500	Wytrzymałość izolacji	1000 MΩ at 500 V DC
Moisture Level (MSL)	1	Klasa palności wg UL 94	V-0
podstawowy materiał styku	Fosforo-brąz	Powierzchnia styku	Złoto na niklu
Struktura warstwowa wtyku	30-80 μ" Ni / 30- μ" Au	Temperatura magazynowania, min.	-40 °C
Temperatura magazynowania, max.	85 °C	Temperatura pracy, min.	-40 °C
Temperatura pracy, max.	85 °C		

Opakowanie

opakowanie	Tape	Długość VPE	0 m
Szerokość VPE	0 m	Wysokość VPE	0 m
Średnica rolki taśmy Ø (A)	330 mm	Odporność powierzchni	Rs = 10 ⁹ - 10 ¹² Ω

**OMNIMATE Data - gniazda RJ45
RJ45C5 R1V 3.2N4N RL****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Dane techniczne**Klasyfikacje**

ETIM 6.0	EC002637	eClass 6.2	27-25-05-04
eClass 9.0	27-44-04-02	eClass 9.1	27-44-04-02

certyfikaty

Dopuszczenia



ROHS

Zgodny

Pobieranie

Dane projektowe

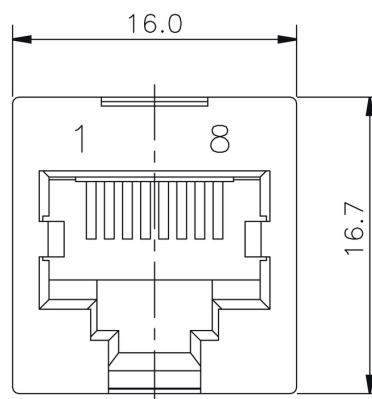
[STEP](#)

OMNIMATE Data - gniazda RJ45 RJ45C5 R1V 3.2N4N RL

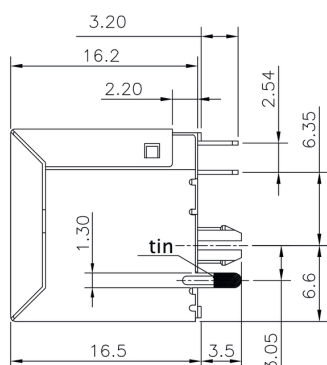
Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Rysunki

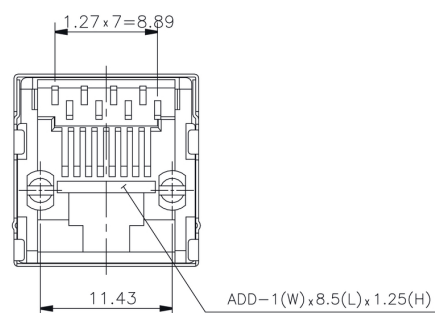
Rysunek wymiarowy



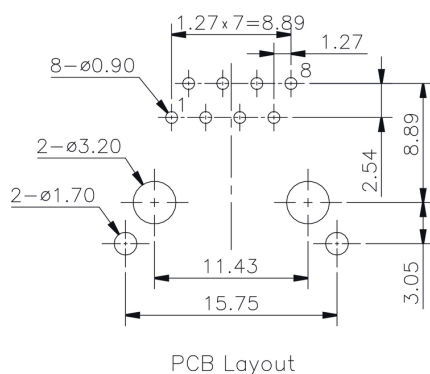
Rysunek wymiarowy



Rysunek wymiarowy



Układ płytek obwodu drukowanego

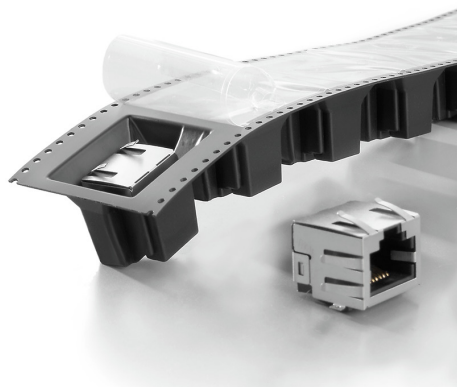


**OMNIMATE Data - gniazda RJ45
RJ45C5 R1V 3.2N4N RL**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Rysunki

Zaleta produktu



Process-optimised packaging
Tape-on-reel or tray

Zaleta produktu

Zaleta produktu



Trouble-free assembly
Short, chamfered solder pins



Suitable for all soldering processes
SMT, THT or THR

Data sporządzenia 3 lipca 2019 16:13:20 CEST

Aktualizacja katalogu 07.06.2019 / Zmiany techniczne zastrzeżone

OMNIMATE Data - gniazda RJ45
RJ45C5 R1V 3.2N4N RL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Rysunki

Legenda

RJ45	G	R	I	U	3.2	E	4	G/Y/GY	T	JY RJ45G1 RIU 3.2E4GY/GY TY
								Packaging	TY RL	Tray in box (manual assembly) Tape on Reel (automated assembly)
								LED	Y/G G/Y GY/GY O/O R/O ... N	Yellow/Green Green/Yellow (standard) Yellow/Green-Yellow Orange-Green Red/Orange ... (further combinations possible) without LED
								Contact surface thickness	4	1 = 3µ", 2 = 6µ", 3 = 15µ", 4 = 30µ", 5 = 50µ"
								EMI tabs (ground fingers)	E N	E = with EMI tabs N = without EMI tabs
								Solder Pin length	3.2 1.6 D	3.2 mm 1.6 mm SMD
								Direction, latch style	U D V Y	Horizontal (90°, side entry), latch up Horizontal (90°, side entry), latch down Vertical (180°, top entry) Diagonal (45°), latch up
								Number of Ports	1 12; 14; ... 21; 41; ...	1 Port multi ports side by side, Multiport multi ports about each other, Multilevel
								Assembly on PCB	R S T	Through Hole Reflow - THR Soldering process: Wave or Reflow soldering Surface Mount Technology - SMT Soldering process: Reflow soldering Through Hole Technology - THT Soldering process: Wave
								Performance Category	C5 C6 CSA C5e M G1 G10 U NP NP+	Category 5 Category 6 Category 6A Category 5e 10/100 Mbit 10/100/1000 Mbit 10 Gbit Unshielded 10/100 Mbit with POE 10/100 Mbit with POE+

Recommended wave soldering profiles

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Single Wave:



Double Wave:



Wave soldering profiles

Wired connection elements should be processed in accordance with the DIN EN 61760-1 standard. We have included two recommendations for practical wave soldering profiles, with which Weidmüller PCB terminals and connectors are qualified.

When choosing a suitable profile for your application, the following factors also need to be considered:

- PCB thickness
- Proportion of Cu in the layers
- Single/double-sided assembly
- Product range
- Heating and cooling rates

The single and double wave profiles each indicate the recommended operating range, including the maximum soldering temperature of 260°C. In practice, the maximum soldering temperature is quite often well below the above maximum profile.

We reserve the right to make technical changes.

Recommended reflow soldering profile

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com



Reflow soldering profile

The perfect soldering profile for SMT Surface Mount Technology is one the most exiting question in SMT production. But there are more than one correct answer: The diagram of temperature-on-time is related to processing features of solder paste and to maximum load of components.

We have to consider the following parameters:

- Time for pre heating
- Maximum temperature
- Time above melting point
- Time for cooling
- Maximum heating rate
- Maximum cooling rate

We recommend a typical solder profile with associated process limits. With preheating components and board are prepared smoothly for the solder phase. Heating rate is typically $\leq +3\text{K/s}$. In parallel the solder paste is 'activated'. The time above melting point of 217°C the paste gets liquid and components and boards begin to connect. The maximum temperature of 245°C to 254°C should stay between 10 and 40 seconds. In the cooling phase at $\geq -6\text{K/s}$ solder is cured. Board and components cool down while avoiding cold cracks.